

YS100

高速通用模块贴片机



- ✓ 25,000CPH(相当于0.14秒/CHIP:最佳条件)的高速贴装能力
- ✓ 全部时间,贴装绝对精度 $\pm 50\mu\text{m}$ (CHIP)、 $\pm 30\mu\text{m}$ (QFP)
- ✓ 可对应长至0402 CHIP~ $\square 45\text{mm}$ 元件、长接头的广范围元件
- ✓ 对象元件15mm对应高度
- ✓ 对应L尺寸基板(L510 \times W460mm)
- ✓ 对应主体内置式割带器选配件。
- ✓ 符合CE安全规格(EC机械指令及EMC指令)

基本规格

机型	YS100(型号:KJJ-000)
对象基板	L50 \times W50mm ~L510 \times W460mm (注1)(注2)
贴装效率 (最佳条件)	25,000CPH(相当于0.14秒/CHIP)
贴装精度 (本公司标准 元件)	绝对精度($\mu+3\sigma$): $\pm 0.05\text{mm}$ /CHIP、 $\pm 0.05\text{mm}$ /QFP 重复精度(3σ): $\pm 0.03\text{mm}$ /CHIP、 $\pm 0.03\text{mm}$ /QFP
对象元件	0402(mm系名称)~ $\square 45\text{mm}$ 元件、SOP/SOJ、QFP、接头、PLCC、CSP/BGA、长接头(W45 \times L 100mm以下)(注3)(注4)可贴装元件高度15mm以下(注5)
元件种类	96种(最大/换算成8mm卷带)(注1)
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz
供气源	0.45MPa以上、清洁干燥状态
外形尺寸 (注6)	L1,665 \times W1,562(盖板端) \times H1,445mm(盖板上方) L1,665 \times W1,615(整批更换台车导轨端) \times H1,445m(盖板上方)
主体重量	约1,630kg(仅主体)

(注1)根据sATS/dYTF的组装机械配置而有所不同。

(注2)二段(上推)顶板规格时,需进行协商。

(注3)FNC头类型时,为~ $\square 31\text{mm}$ 元件。

(注4)大型元件及长接头时,关于偏心偏移量及旋转角度,需进行协商。

(注5)FNC头类型时,搬入前基板上方高度须在4mm以下。

(注6)不包括突起部分的尺寸。